



SPRS TECHNOLOGIES

P/N:STHP100-H062

Thin Film Planar Filters

## 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

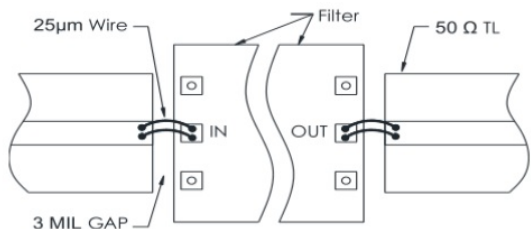
技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| 参数   | 最小          | 典型  | 最大   | 单位  |
|------|-------------|-----|------|-----|
| 工作频率 | 10.0        |     | 23.0 | GHz |
| 插入损耗 |             | 1.2 | 1.5  | dB  |
| 带内波动 |             | 0.6 | 1.0  | dB  |
| 回波损耗 | 12          | 15  |      | dB  |
| 带外抑制 | @5.8-7.7GHz | 30  | 35   | dBc |
|      | @DC-5.8GHz  | 35  | 40   | dBc |
|      |             |     |      |     |

环境要求

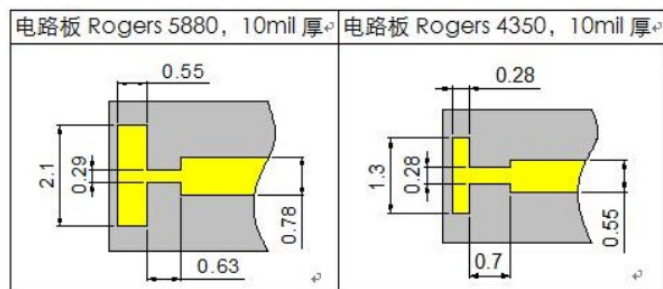
|        |                                             |     |
|--------|---------------------------------------------|-----|
| 最大输入功率 | 25                                          | dBm |
| 工作温度   | $-55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$  |     |
| 储存温度   | $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ |     |

推荐装配图



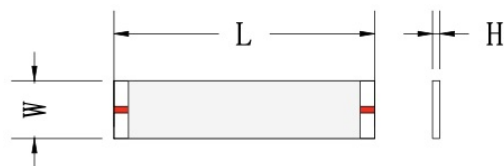
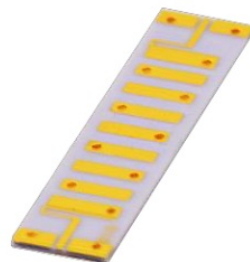
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 ( $6.7\text{ppm}/^\circ\text{C}$ )，载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：



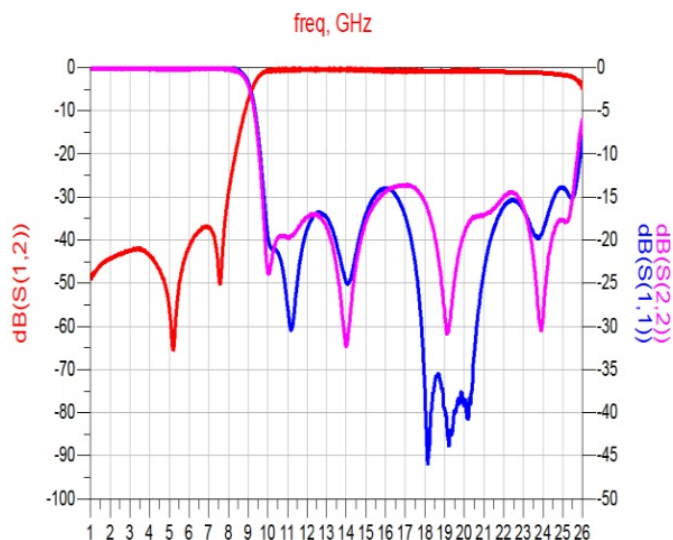
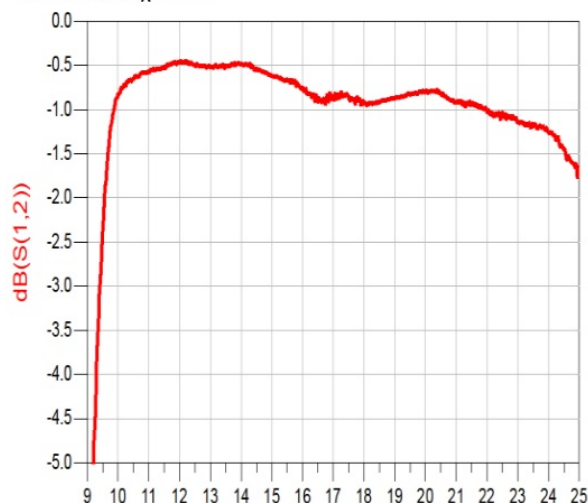
注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

外形图



| 外形尺寸 | L   | W   | H     | 单位 |
|------|-----|-----|-------|----|
|      | 3.2 | 2.5 | 0.254 | mm |

典型曲线,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



注：T 型图形顶端基板白边 0.1mm；频率 10GHz 以下无需匹配。

freq, GHz

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 [www.com-mw.com](http://www.com-mw.com)

商城 [www.dianzibuy.com](http://www.dianzibuy.com)

电话 15608095669

邮箱 [sales@com-mw.com](mailto:sales@com-mw.com)